

政策链接

关于提高集成电路和工业母机企业研发费用 加计扣除比例的公告

财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部公告

2023年第44号

为进一步鼓励企业研发创新，促进集成电路产业和工业母机产业高质量发展，现就有关企业研发费用税前加计扣除政策公告如下：

一、集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。

二、第一条所称集成电路企业是指国家鼓励的集成电路生产、设计、装备、材料、封装、测试企业。具体按以下条件确定：

（一）国家鼓励的集成电路生产企业是指符合《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发

展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号)第一条规定的生产企业或项目归属企业,企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同财政部、税务总局等部门制定。

(二)国家鼓励的集成电路设计企业是指符合《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号)第四条规定的重点集成电路设计企业,企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同财政部、税务总局等部门制定。

(三)国家鼓励的集成电路装备、材料、封装、测试企业是指符合《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告(2021年第9号)》规定条件的企业。如有更新,从其规定。

三、第一条所称工业母机企业是指生产销售符合本公告附件《先进工业母机产品基本标准》产品的企业,具体适用条件和企业清单由工业和信息化部会同国家发展改革委、财政部、税务总局等部门制定。

四、企业享受研发费用加计扣除政策的其他政策口径和管理要求,按照《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)、《财政部 税务总局 科技部关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除

有关政策问题的通知》（财税〔2018〕64号）等文件相关规定执行。

五、本公告规定的税收优惠政策，采用清单管理的，由国家发展改革委、工业和信息化部于每年3月底前按规定向财政部、税务总局提供上一年度可享受优惠的企业清单；不采取清单管理的，税务机关可按《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号）规定的核查机制转请发展改革、工业和信息化部门进行核查。

特此公告。

财政部

税务总局

国家发展改革委

工业和信息化部

2023年9月12日

附件

先进工业母机产品基本标准

一、金属切削机床

定位精度 ≤ 10 微米/米，并安装数控系统。

二、铸造装备

1.真空熔铸装备：坩埚容量 ≥ 50 千克。

2.感应熔炼电炉：熔化量 ≥ 10 吨。

3.粘土砂造型线：静压造型生产线造型效率 ≥ 100 型/小时,砂箱尺寸1200毫米 \times 1000毫米及以上；垂直造型线造型效率 ≥ 400 型/小时。

4.大型自硬砂成套设备：处理能力 ≥ 60 吨/小时的连续式混砂机，60吨级及以上振实台、起模机。

5.高压压铸机：合模力 ≥ 6000 吨。

6.挤压铸造成套设备：锁模力 ≥ 1000 吨。

7.气力输送铸造废砂再生设备：处理能力30吨/小时以上，旧砂回用率水玻璃砂90%以上、树脂砂94%以上。

三、锻压装备

1.数控液压机：公称压力 ≥ 1000 吨。

2.数控多连杆机械压力机：公称压力 ≥ 1000 吨，冲压生产线 ≥ 2000 吨（总吨位）。

3.冷锻机械压力机：公称压力 ≥ 630 吨。

4.热模锻压力机：公称压力 ≥ 2000 吨。

5.热等静压装备：有效热区直径 ≥ 1000 毫米。

四、焊接装备

1.数字化弧焊装备：数控系统跟踪补偿精度 0.1 毫米—0.5 毫米、焊接工艺参数波动小于 2%—5%。

2.激光、电子束等高能束焊接装备：机电协同控制精度 1%、跟踪补偿精度 0.1 毫米—0.5 毫米、焊接工艺参数波动小于 2%。

3.惯性、搅拌摩擦焊及电阻焊装备：机电协同控制精度 1%、响应速度 5 毫秒—10 毫秒；数控系统跟踪补偿精度 0.05 毫米—0.1 毫米。

五、热处理装备

1.真空热处理装备：装炉量 ≥ 1 吨。

2.控制气氛热处理装备：装炉量 ≥ 1 吨。

3.绝缘栅双极型晶体管电源感应热处理装备。

4.连续热处理生产线：生产能力 ≥ 1 吨/小时。

5.自动电镀设备：行车上自带独立控制箱和主可编程逻辑控制器网络通信，具备四轴运动能力。

6.低压等离子喷涂设备：真空室尺寸 $\geq \Phi 2000$ 毫米 $\times 3000$ 毫米，喷枪使用功率 ≥ 80 千瓦。

7.溶液等离子喷涂设备：喷枪使用功率 ≥ 100 千瓦，浆料输送率 ≥ 0.5 升/分。

8.真空镀膜装备：膜层不均匀性 $\leq\pm 10\%$ ，故障诊断节点数 ≥ 1000 。

六、数控装置

具备三轴及以上联动控制功能。

七、滚动功能部件（丝杠/导轨）

P3 精度以上。

八、电主轴

动态回转精度 ≤ 10 微米。

九、数控转台

定位精度 $\leq 15''$ 。

十、位置反馈元件（光栅尺/编码器）

直线准确度 $\leq\pm 3$ 微米；旋转准确度 $\leq\pm 2.5''$ 。

十一、摆角头

定位精度 $\leq 15''$ 。

十二、动力刀架刀库

分度精度 $\leq\pm 6''$ ，换刀时间（T-T） ≤ 2.5 秒。

十三、真空系统

1.镀膜机：整机漏率达到 1.0×10^{-8} 帕斯卡·升/秒量级，工作真空度保持时间 ≥ 6 个月。

2.工业炉：漏率达到 1.0×10^{-7} 帕斯卡·升/秒量级，工作真空度保持时间 ≥ 6 个月。